

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

563

ML8

Erstellt:

Landwehr, Melanie

Kunde:

Datum:

15.12.2015



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
		70	L2	
B-RS-FR4-ML-0.20mm-070+070-TG150-HF	50200889	200		4
		70	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	240		5
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		6
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		7
		70	L4	
B-RS-FR4-ML-0.20mm-070+070-TG150-HF	50200889	200		8
		70	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	240		9
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		10
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		11
		70	L6	
B-RS-FR4-ML-0.20mm-070+070-TG150-HF	50200889	200		12
		70	L7	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		13
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		14
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	15

Dicke nach Verpressen

B00:

1860 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2060 µm

Dmin:

1660 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2200 µm

Dmin:

1800 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1926 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik